

令和8年度宮城県半導体海外展示会出展支援業務 想定スケジュール

時期	内容
令和8年4月16日(木)	プロポーザル方式選定委員会
同 4月中旬	選定結果・公表
	出展者募集開始 ※発注者対応
同 5月上旬	契約締結
同 5月中旬	出展小間契約締結・SEMI Taiwan へ小間料金の支払い
同 6月上旬	出展者決定 ※発注者対応
同 7月中旬～下旬	出展ブースのデザイン関係資料の「SEMICON Taiwan 2026」主催者への提出期限
同 9月2日(水)～4日(金)	「SEMICON Taiwan 2026」会期
会期後	出展企業へのアンケート実施
令和9年3月10日(水)まで	業務報告書提出